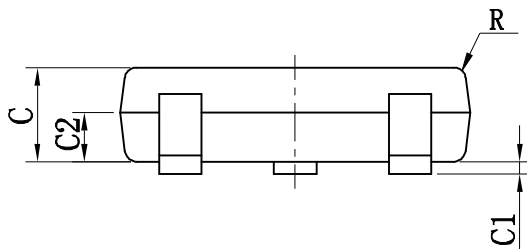
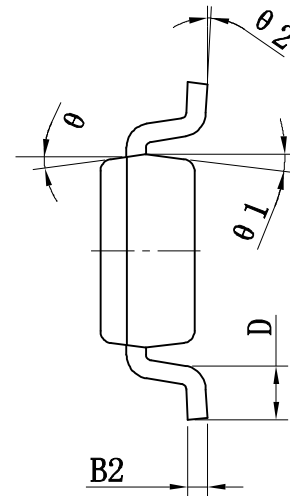
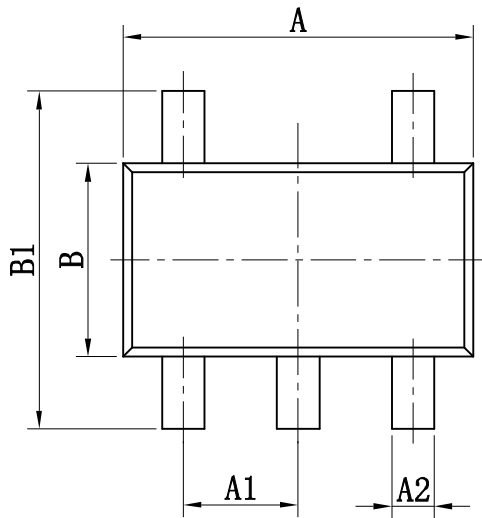




气派科技股份有限公司

China Chippacking Technology Co., Ltd

标注/ SYMBOL	尺寸/ SIZE	最小/MIN (mm)	最大/MAX (mm)	标注/ SYMBOL	尺寸/ SIZE	最小/MIN (mm)	最大/MAX (mm)
A		2.820	3.020	C1		0.000	0.100
A1		0.950 (BSC)		C2		0.378	0.438
A2		0.350	0.500	D		0.300	0.600
B		1.600	1.700	θ		9° TYP4	
B1		2.650	2.950	$\theta 1$		10° TYP4	
B2		0.080	0.200	$\theta 2$		0~8°	
C		0.700	0.800				



制图	邓景勇	2018.04.03	名称	生效日期		
审核			TSOT23-5	等级标记	重量	比例
批准			封装产品图			1:1
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-OL-058	气派科技股份有限公司		
			版次	D	CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd	